



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

RECEIVED
31 MAR 2004
WIPO PCT

Bescheinigung

Certificate

Attestation

Die angehefteten Unterlagen stimmen mit der ursprünglich eingereichten Fassung der auf dem nächsten Blatt bezeichneten europäischen Patentanmeldung überein.

The attached documents are exact copies of the European patent application described on the following page, as originally filed.

Les documents fixés à cette attestation sont conformes à la version initialement déposée de la demande de brevet européen spécifiée à la page suivante.

Patentanmeldung Nr. Patent application No. Demande de brevet n°

03007172.4

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

Der Präsident des Europäischen Patentamts;
Im Auftrag

For the President of the European Patent Office

Le Président de l'Office européen des brevets
p.o.

R C van Dijk



Anmeldung Nr:
Application no.: 03007172.4
Demande no:

Anmeldetag:
Date of filing: 28.03.03
Date de dépôt:

Anmelder/Applicant(s)/Demandeur(s):

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Wittelsbacherplatz 2
80333 München
ALLEMAGNE

Bezeichnung der Erfindung/Title of the invention/Titre de l'invention:
(Falls die Bezeichnung der Erfindung nicht angegeben ist, siehe Beschreibung.
If no title is shown please refer to the description.
Si aucun titre n'est indiqué se referer à la description.)

Halbleiterrelais

In Anspruch genommene Priorität(en) / Priority(ies) claimed /Priorité(s)
revendiquée(s)
Staat/Tag/Aktenzeichen/State/Date/File no./Pays/Date/Numéro de dépôt:

Internationale Patentklassifikation/International Patent Classification/
Classification internationale des brevets:

H03K/

Am Anmeldetag benannte Vertragstaaten/Contracting states designated at date of
filling/Etats contractants désignés lors du dépôt:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LU MC NL
PT SE SI SK TR LI

28. März 2003

Beschreibung

Halbleiterrelais

5 Die Erfindung betrifft ein Halbleiterrelais mit einem im Wesentlichen quaderförmigen Gehäuse. Ein Halbleiterrelais ist beispielsweise aus der DE 199 56 445 C2 bekannt.

Ein Halbleiterrelais oder Halbleiterschütz weist Anschlüsse 10 für einen Haupt- oder Laststromkreis und für einen Steuerstromkreis auf. Sollen zusätzliche Funktionen, beispielsweise eine Überwachungs- oder Messfunktion bereitgestellt werden, so wird dies üblicherweise mit Hilfe eines zusätzlichen Gerätes realisiert, welches mit dem entsprechenden Stromkreis 15 bzw. den entsprechenden Stromkreisen verbunden wird. Hierbei können insbesondere für verschiedene Überwachungsfunktionen unterschiedliche Geräte vorgesehen sein, wobei die Laststromkreisanforderungen vom Einsatz dieser Geräte unabhängig sind. Die Mehrzahl der optional zu verwendenden Geräte bedeutet ei- 20 nen erheblichen Mehraufwand bei Projektierung, Lagerhaltung, Montage und Inbetriebnahme im Vergleich zur Verwendung ausschließlich eines Halbleiterrelais oder Halbleiterschützes. Weiterhin ist der Platzbedarf der zusätzlich zum Relais oder 25 Schütz in einem Schaltschrank zu installierenden Geräte von Bedeutung.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, mit besonders geringem Installationsaufwand und Platzbedarf Zusatzfunktionen in ein Halbleiterrelais oder ein Halbleiterschütz aufweisen- 30 den Stromkreisen zu realisieren.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch ein Halbleiterrelais mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Der Begriff Halbleiterrelais umfasst hierbei auch üblicherweise als Halbleiterschütze bezeichnete Geräte. Das Halbleiterrelais weist ein im Wesentlichen quaderförmiges Gehäuse auf, welches mit einer als Befestigungsseite bezeichneten Seite beispielsweise

an einer Haltevorrichtung, insbesondere einer Tragschiene, oder an einem Kühlkörper befestigbar ist. Die übrigen fünf Seiten des Gehäuses werden zusammenfassend als Anschlussseiten bezeichnet. An einer oder mehrerer dieser Seiten sind 5 elektrische Anschlüsse vorgesehen. Mit mindestens einer der Anschlussseiten ist ein auf das Gehäuse aufsetzbares Funktionsmodul verbindbar. Vorzugsweise kontaktiert ein einziges Funktionsmodul das Gehäuse an mehreren Seiten, insbesondere an einer senkrecht zur Befestigungsseite angeordneten Seiten- 10 fläche sowie an einer der Befestigungsseite gegenüberliegenden Frontseite. Hierbei kann beispielsweise vorgesehen sein, dass eine Seite des Gehäuses mit einer Seite des Funktionsmoduls lediglich mechanisch verbunden ist, während eine weitere Seite des Gehäuses mit einer weiteren Seite des Funktionsmoduls sowohl mechanisch als auch elektrisch verbunden 15 ist. Das Funktionsmodul ist mit dem Steuerstromkreis und/oder Laststromkreis des Halbleiterrelais verbunden.

Die Verbindung des Funktionsmoduls mit dem Gehäuse des Halbleiterrelais ist vorzugsweise werkzeuglos herstellbar sowie 20 lösbar, insbesondere mittels einer Schnappverbindung. Alternativ oder zusätzlich kann jedoch beispielsweise auch eine Schraubverbindung vorgesehen sein. Vorzugsweise sind an ein einziges Gehäuse eines Halbleiterrelais mehrere Funktionsmodule ankoppelbar. Ebenso kann die Verbindung zwischen 25 mehreren Funktionsmodulen vorgesehen sein.

Das auf das Relaisgehäuse aufsetzbare Funktionsmodul ist vorzugsweise nicht breiter - bezogen auf die Erstreckung einer Tragschiene - als das Gehäuse selbst, so dass die Anordnung aus Halbleiterrelais und Funktionsmodul praktisch keinen zusätzlichen Raum in einem Schaltschrank benötigt. Das Funktionsmodul zeichnet sich auch dadurch aus, dass es auf sehr einfache Weise in bestehenden Schaltanlagen nachrüstbar ist. 30

35 Die mechanische und die elektrische Verbindung des Funktionsmoduls mit dem Halbleiterrelais kann nacheinander oder

gleichzeitig erfolgen. Das Herstellen der elektrischen Verbindung zwischen dem Funktionsmodul und dem Halbleiterrelais mit der Verbindung der jeweiligen Gehäuse minimiert den Verdrahtungsaufwand und stellt gleichzeitig eine Sicherung gegen

5 Verdrahtungsfehler dar. Hierbei sind im Gehäuse des Halbleiterrelais sowie im Funktionsmodul korrespondierende Kontaktierungselemente, beispielsweise Federkontakte vorgesehen, die eine Kontaktierung der Ansteuerelektronik des Halbleiterrelais ermöglichen, wodurch das Funktionsmodul direkt Einfluss auf die Ansteuerung im Halbleiterrelais nehmen kann.

10 Die elektrischen Eigenschaften des mit dem Funktionsmodul erweiterten Halbleiterrelais sind vorzugsweise identisch mit den Eigenschaften eines Abzweigs ohne zusätzliche Funktionen. Diese Unabhängigkeit der elektrischen Eigenschaften des

15 Haupt- oder Laststromkreises vom Vorhandensein und den Eigenschaften des Funktionsmoduls bedeutet eine rationelle Projektierung sowie erhebliche Einsparungen bei der Lagerhaltung. Insgesamt ist mit dem Halbleiterrelais und den mit diesen kompatiblen Funktionsmodulen eine durchgängig und modular

20 ausbaubare Produktfamilie gegeben, wobei das Halbleiterrelais auch ohne mit diesem verbundenes Funktionsmodul uneingeschränkt einsatzfähig ist.

Um den in einem Schaltschrank zur Montage des Funktionsmoduls

25 zur Verfügung stehenden, an das Halbleiterrelais grenzenden Raum besonders gut auszunutzen, weist das Funktionsmodul nach einer bevorzugten Ausgestaltung nicht nur einen an die Frontseite des Halbleiterrelais anschließenden Teil, sondern auch einen an eine Seitenfläche, nämlich eine parallel zur Tragschiene ausgerichtete Seitenfläche anschließenden Teil auf.

30 Der letztgenannte Teil weist dabei eine so genannte Basisseite auf, welche mit der Befestigungsseite des Halbleiterrelais zumindest annähernd fluchtet. Dieser Basisseite liegt an der Vorderseite des Funktionsmoduls bevorzugt eine Steckverbindungsleiste gegenüber.

35

Weist das Gehäuse des Halbleiterrelais eine Öffnung auf, welche auch bei aufgesetztem Funktionsmodul zugänglich bleiben sollte, so sind gemäß einer bevorzugten Ausführungsform beidseitig der Öffnung zwei Befestigungsschenkel am Funktionsmodul angeformt, welche vorzugsweise zur Herstellung einer Schnappverbindung zwischen dem Funktionsmodul und dem Gehäuse des Halbleiterrelais vorgesehen sind. Die Befestigungsschenkel sind dabei, sofern sich die Öffnung an der Frontseite des Gehäuses befindet, parallel zu zwei Seitenflächen des Gehäuses ausgerichtet, wobei die Schnappverbindungselemente der Befestigungsschenkel an einer Kante zwischen der Frontseite und einer Seitenfläche des Gehäuses des Halbleiterrelais mit diesem verrastbar sind.

Das Funktionsmodul kann beispielsweise eine oder mehrere folgende Funktionen umfassen: Überwachung des Laststromkreises, Leistungsregelung im Laststromkreis, Strommessung, Analog-Digital-Signalwandlung. Das Funktionsmodul kann mittels analoger und/oder digitaler Signale ansteuerbar sein. Der Vorteil der Erfahrung liegt insbesondere darin, dass durch vorkonfektionierte und/oder nachrüstbare auf ein Halbleiterrelais oder ein Halbleiterschütz aufschnappbare Funktionsmodule die Funktionalität des Relais auf einfache Weise modular erweiterbar ist und/oder Zusatzfunktionen bevorzugt im Steuerstromkreis realisierbar sind.

Nachfolgend werden mehrere Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand einer Zeichnung näher erläutert. Hierin zeigen:

FIG 1 bis 3 jeweils ein Ausführungsbeispiel eines Funktionsmoduls für ein Halbleiterrelais,

FIG 4 ein Halbleiterrelais und ein mit diesem verbindbares Funktionsmodul,

FIG 5 bis 8 jeweils ein Ausführungsbeispiel eines Halbleiterrelais,

FIG 9 mehrere Halbleiterrelais und mit diesen zusammenwirkende Funktionsmodule, und

FIG 10 ein Halbleiterrelais und mehrere schematisch dargestellte Funktionsmodule.

Einander entsprechende Teile sind in allen Figuren mit den 5 gleichen Bezugszeichen versehen.

Die FIG 1 bis 3 zeigen jeweils eine Ausführungsform eines Funktionsmoduls 1 für ein Halbleiterrelais oder ein Halbleiterenschütz. Das Funktionsmodul 1 greift zumindest in den Steuerstromkreis des Halbleiterrelais ein und ersetzt herkömmliche Geräte, die zur Ansteuerung eines Halbleiterrelais mit diesem zu verdrahten sind. Die FIG 4 zeigt das auch in FIG 3 dargestellte Funktionsmodul 1 zusammen mit einem zugehörigen Halbleiterrelais 2. Das Halbleiterrelais 2 weist eine zur Befestigung an einer tragenden Struktur vorgesehene Befestigungsseite 3, zwei Längsseiten 4,5 und zwei Querseiten 6,7, zusammenfassend als Seitenflächen 4,5,6,7 bezeichnet, sowie eine der Befestigungsseite 3 gegenüberliegende Frontseite 8 auf. Die Längs- und Querseiten 4,5,6,7 und die Frontseite 8 werden einheitlich auch als Anschlussseiten bezeichnet, wobei im dargestellten Ausführungsbeispiel an den Längsseiten 4,5, keine Anschlüsse vorgesehen sind. Das aus einem Kunststoff hergestellte Gehäuse des Halbleiterrelais 2 weist eine im Wesentlichen quaderförmige Gestalt auf und trägt das Bezugszeichen 20. Von den Querseiten 6,7 des Gehäuses 20 aus sind dem Haupt- oder Laststromkreis zugeordnete Hauptanschlüsse 9,10 zugänglich, während von der Frontseite 8 aus mehrere Anschlussbuchsen 11,12 zugänglich sind. In die Anschlussbuchsen 11,12 als elektrische Verbindungselemente greifen Stifte 13 bzw. ein Stecker 14 des Funktionsmoduls 1 ein. Die Stifte 13 kontaktieren nicht sichtbare Kontaktflächen im Halbleiterrelais 2 und bilden Federkontakte. Sämtliche elektrischen Verbindungselemente zwischen dem Halbleiterrelais 2 und dem Funktionsmodul 1 befinden sich damit an der Frontseite 8 bzw. einer mit dieser korrespondierenden Kontaktierungsseite 15 des Funktionsmoduls 1 oder sind von der jeweiligen Seite 8,15 aus zugänglich. Eine zusätzliche Verdrahtung zwischen dem

Funktionsmodul 1 und dem Halbleiterrelais 2 ist nicht erforderlich. Das Halbleiterrelais 2 ist je nach Anforderungen mit unterschiedlichen Funktionsmodulen 1 kombinierbar. Sofern das Funktionsmodul 1, welches beispielsweise zur Stromregelung im 5 Laststromkreis vorgesehen ist, sowohl steuerstromseitig als auch laststromseitig mit dem Halbleiterrelais 2 zu verbinden ist, sind diese Verbindungen mit dem Aufschnappen des Funktionsmoduls 1 auf das Halbleiterrelais 2 automatisch hergestellt. Die Gefahr einer Fehlkontaktierung ist somit prinzipiell 10 bedingt ausgeschlossen.

Die in den FIG 2 bis 4 dargestellten Funktionsmodule 1 weisen im Wesentlichen eine L-Form auf, wobei der erste, längere L-Schenkel an der Frontseite 8 des Halbleiterrelais 2 und der zweite, kürzere L-Schenkel an der Querseite 7 anliegt. Letztgenannter L-Schenkel ist begrenzt durch eine Basisseite 16, welche in gerader Verlängerung der Befestigungsseite 3 des Halbleiterrelais 2 angeordnet ist. Rechtwinklig zur Basisseite 16 verläuft, an die Querseite 7 angrenzend, eine Fixierseite 17 des Funktionsmoduls 1, welche eine Nut 18 aufweist, die mit einer als korrespondierendes mechanisches Verbindungselement dienenden Schiene 19 auf der Querseite 7 des Gehäuses 20 des Halbleiterrelais 2 zusammenwirkt. Das Funktionsmodul 1, dessen Gehäuse 32 ebenso wie das Gehäuse 20 des Halbleiterrelais 2 aus Kunststoff gefertigt ist, ist somit auf dieses aufschiebbar. Auf der gegenüberliegenden Querseite 6 ist eine Schnappverbindung 21 vorgesehen, welche das Funktionsmodul 1 an einer Kante 22 des Gehäuses 20 fixiert. Die Schnappverbindung 21 wird gebildet aus zwei Schnapphaken 23, welche in weitere mechanische Verbindungselemente bilden. Vertiefungen 24 auf der Querseite 6 einrasten. Die Schnapphaken 23 sind federnd angeformt an jeweils einem Befestigungsschenkel 25 am Funktionsmodul 1, welcher parallel zu den Längsseiten 4,5 ausgerichtet ist. Zwischen den Befestigungsschenkeln 25 verbleibt ein Freiraum, um die Zugänglichkeit einer dem Hauptanschluss 9 zugeordneten Öffnung 26 des Gehäuses 20 auch bei auf dieses aufgeschnapptem Funkti-

onsmodul 1 zu gewährleisten. Eine weitere, dem Hauptanschluss 10 zugeordnete Öffnung 27 im Gehäuse 20 ist durch eine Betätigungsöffnung 28 im Gehäuse 32 des Funktionsmoduls 1 zugänglich. Frontseitig des Funktionsmoduls 1 befindet sich eine 5 Steckverbindungsleiste 29, welche der Basisseite 16 gegenüberliegt.

Die FIG 5 bis 8 zeigen jeweils ein Halbleiterrelais 2, wobei die in FIG 5 dargestellte Ausführungsform der Bauform nach 10 FIG 4 entspricht. In den FIG 6 und 8 ist jeweils ein ebenfalls unter dem Begriff Halbleiterrelais subsummiertes, an einem Kühlkörper 30 befestigtes Hälbleiterschütz 2 dargestellt. Der Kühlkörper weist rückseitig, d.h. dem Halbleiterrelais 2 gegenüberliegend, eine Aussparung 31 auf, mittels 15 derer eine Befestigung des Relais 2 an einer nicht dargestellten Tragschiene, die normal zu den Längsseiten 4,5 verläuft, möglich ist.

Im Ausführungsbeispiel nach FIG 9 sind mehrere Halbleiterrelais 2 an einem gemeinsamen Kühlkörper 30 befestigt. Beispielsweise sind des Weiteren zwei Funktionsmodule 1 in der Bauform nach FIG 1 dargestellt, von welchen eines auf ein Halbleiterrelais 2 aufgeschnappt ist. Zum Aufschnappen des Funktionsmoduls 1 auf das Halbleiterrelais 2 ist ebenso wie 25 zur Demontage kein Werkzeug erforderlich.

Das Ausführungsbeispiel nach FIG 10 zeigt ein Halbleiterrelais 2 sowie fünf lediglich symbolisch dargestellte Funktionsmodule 1, die an sämtlichen Anschlussseiten 4,5,6,7,8 des Gehäuses 20 befestigbar sind. Zusätzlich zur elektrischen und mechanischen Verbindung zwischen dem Halbleiterrelais 2 und den Funktionsmodulen 1 können solche Verbindungen auch in nicht näher dargestellter Weise zwischen den einzelnen Funktionsmodulen 1 vorgesehen sein.

Patentansprüche

1. Halbleiterrelais mit einem im Wesentlichen quaderförmigen Gehäuse (20), welches eine Befestigungsseite (3) sowie vier senkrecht zu dieser angeordnete Seitenflächen (4,5,6,7) und eine der Befestigungsseite (3) gegenüberliegende Frontseite (8) als Anschlussseiten (4,5,6,7,8) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass an einer Anzahl Anschlussseiten (4,5,6,7,8) insgesamt mindestens ein elektrisches Verbindungselement (11,12) und mindestens ein mechanisches Verbindungselement (19,24) zum Anschluss eines mit dem Gehäuse (20) verbindbaren Funktionsmoduls (1) vorgesehen sind.
- 15 2. Halbleiterrelais nach Anspruch 1,
gekennzeichnet durch ein mit zwei Anschlussseiten (4,5,6,7,8) verbundenes Funktionsmodul (1).
- 20 3. Halbleiterrelais nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Funktionsmodul (1) zur Laststromkreisüberwachung vorgesehen ist.
- 25 4. Halbleiterrelais nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das Funktionsmodul (1) zur Leistungsregelung im Laststromkreis vorgesehen ist.
- 30 5. Halbleiterrelais nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das Funktionsmodul (1) mittels eines Analogsignals ansteuerbar ist.
- 35 6. Halbleiterrelais nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das Funktionsmodul (1) zur Strommessung vorgesehen ist.
7. Halbleiterrelais nach einem der Ansprüche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, dass das Funktionsmodul (1) zur Analog-Digital-Signalwandlung vorgesehen ist.

5 8. Halbleiterrelais nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Funktionsmodul (1) werkzeuglos mit dem Gehäuse (20) verbindbar ist.

10 9. Halbleiterrelais nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Funktionsmodul (1) auf das Gehäuse (20) aufschnappbar ist.

15 10. Halbleiterrelais nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Funktionsmodule (1) mit dem Gehäuse (20) verbindbar sind.

20 11. Halbleiterrelais nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Funktionsmodul (1) eine mit der Befestigungsseite (3) des Gehäuses (20) fluchtende Basisseite (16) aufweist.

25 12. Halbleiterrelais nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Funktionsmodul (1) zwei beidseitig einer Öffnung (26) des Gehäuses (20) angeordnete, parallel zu jeweils einer Seitenfläche (4,5,6,7) ausgerichtete Befestigungsschenkel (25) aufweist.

Zusammenfassung**Halbleiterrelais**

5 Ein Halbleiterrelais (2) weist ein im Wesentlichen quaderförmigen Gehäuse (20) auf, welches eine Befestigungsseite (3) sowie vier senkrecht zu dieser angeordnete Seitenflächen (4, 5, 6, 7) und eine der Befestigungsseite (3) gegenüberliegende Frontseite (8) als Anschlussseiten (4, 5, 6, 7, 8) hat, wobei an
10 einer Anzahl Anschlussseiten (4, 5, 6, 7, 8) insgesamt mindestens ein elektrisches Verbindungselement (11, 12) und mindestens ein mechanisches Verbindungselement (19, 24) zum Anschluss eines mit dem Gehäuse (20) verbindbaren Funktionsmoduls (1) vorgesehen sind.

15

FIG 4

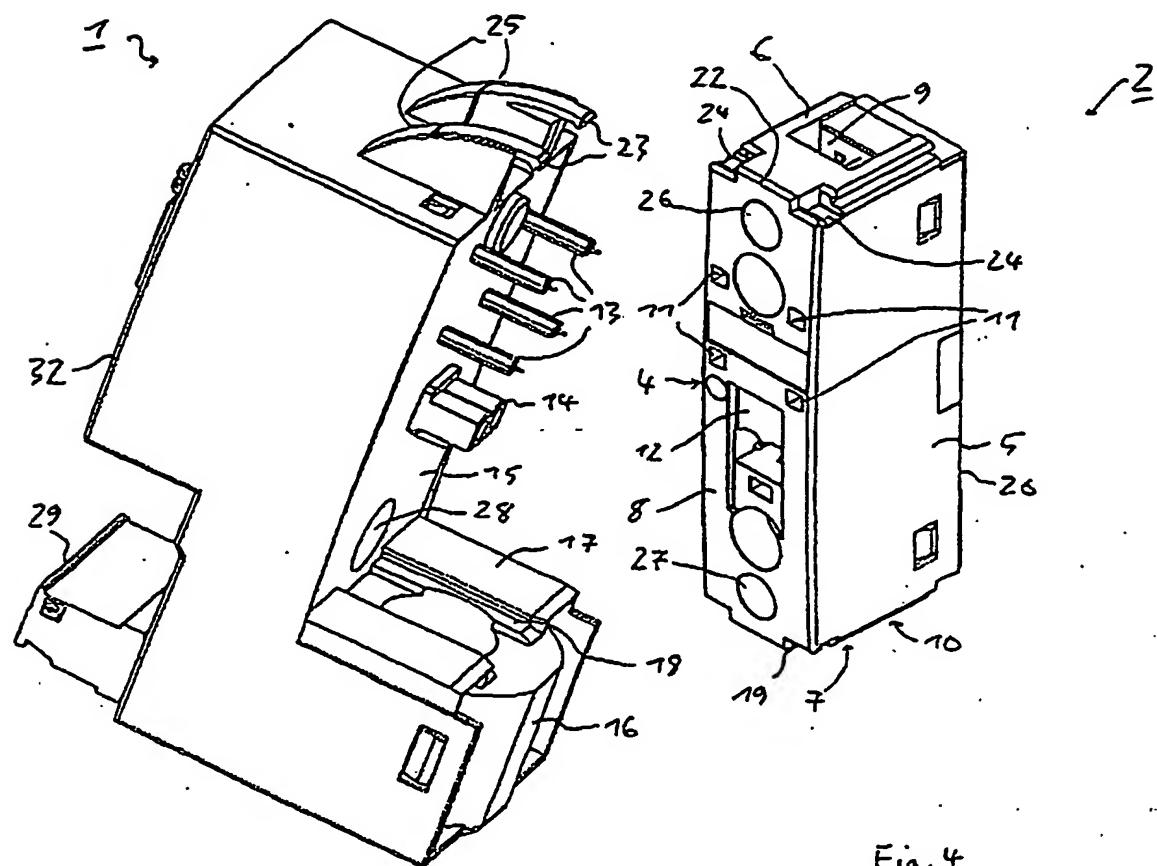
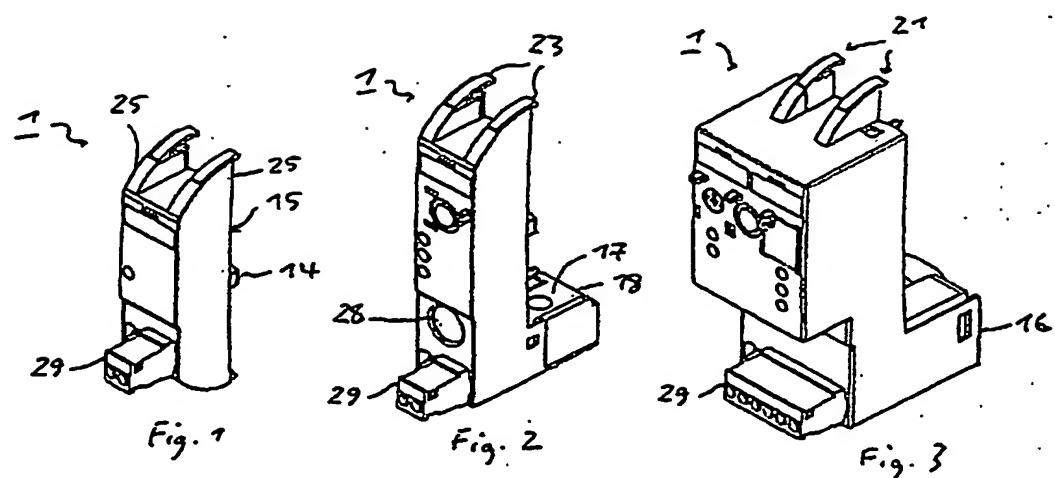
200303i19

714

EPO - Munich

75

28. März 2003



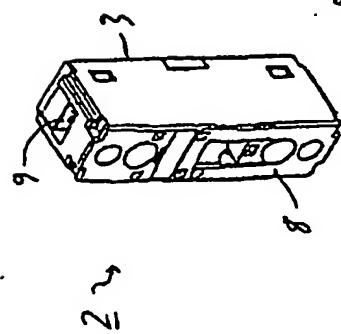
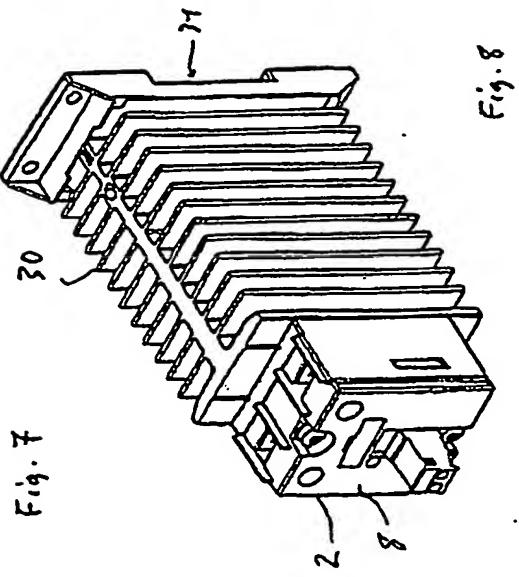
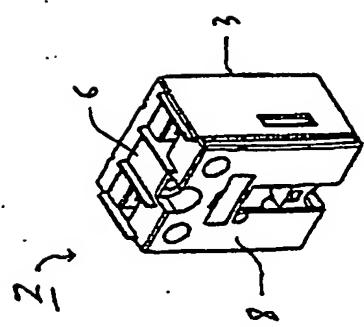


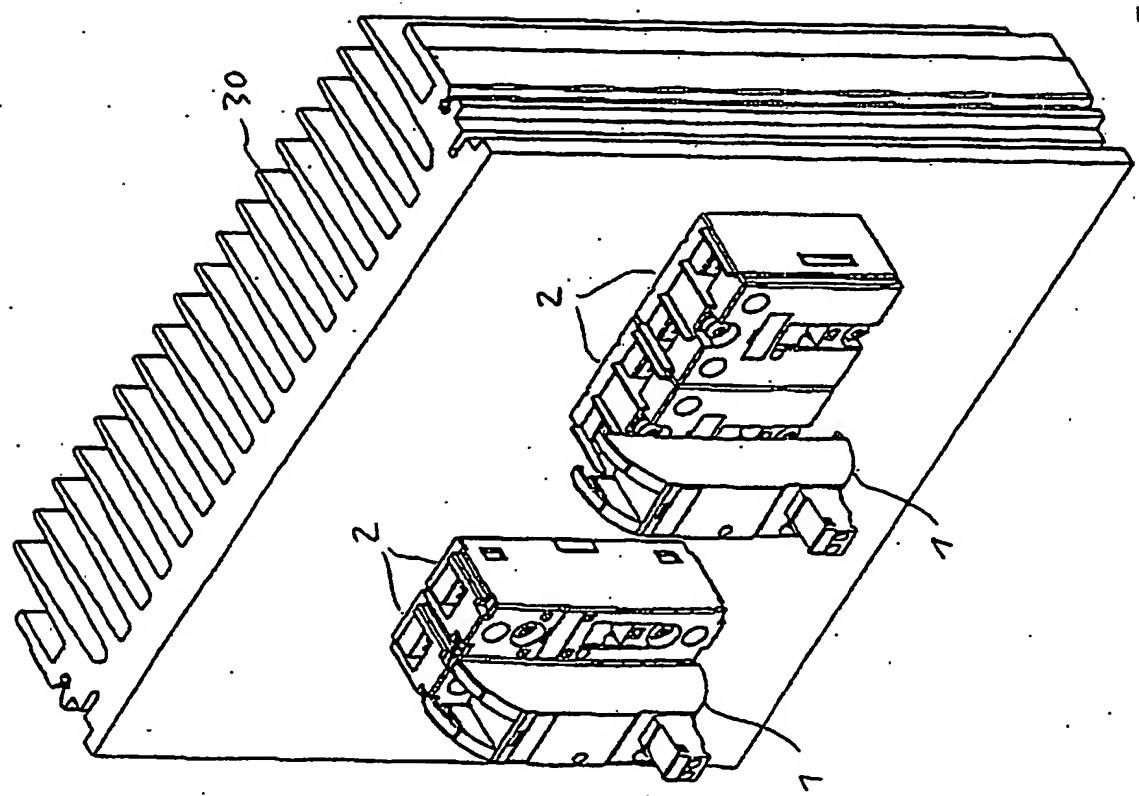
Fig. 7

Fig. 8

200303119

3.14

Fig. 9



200303119

414

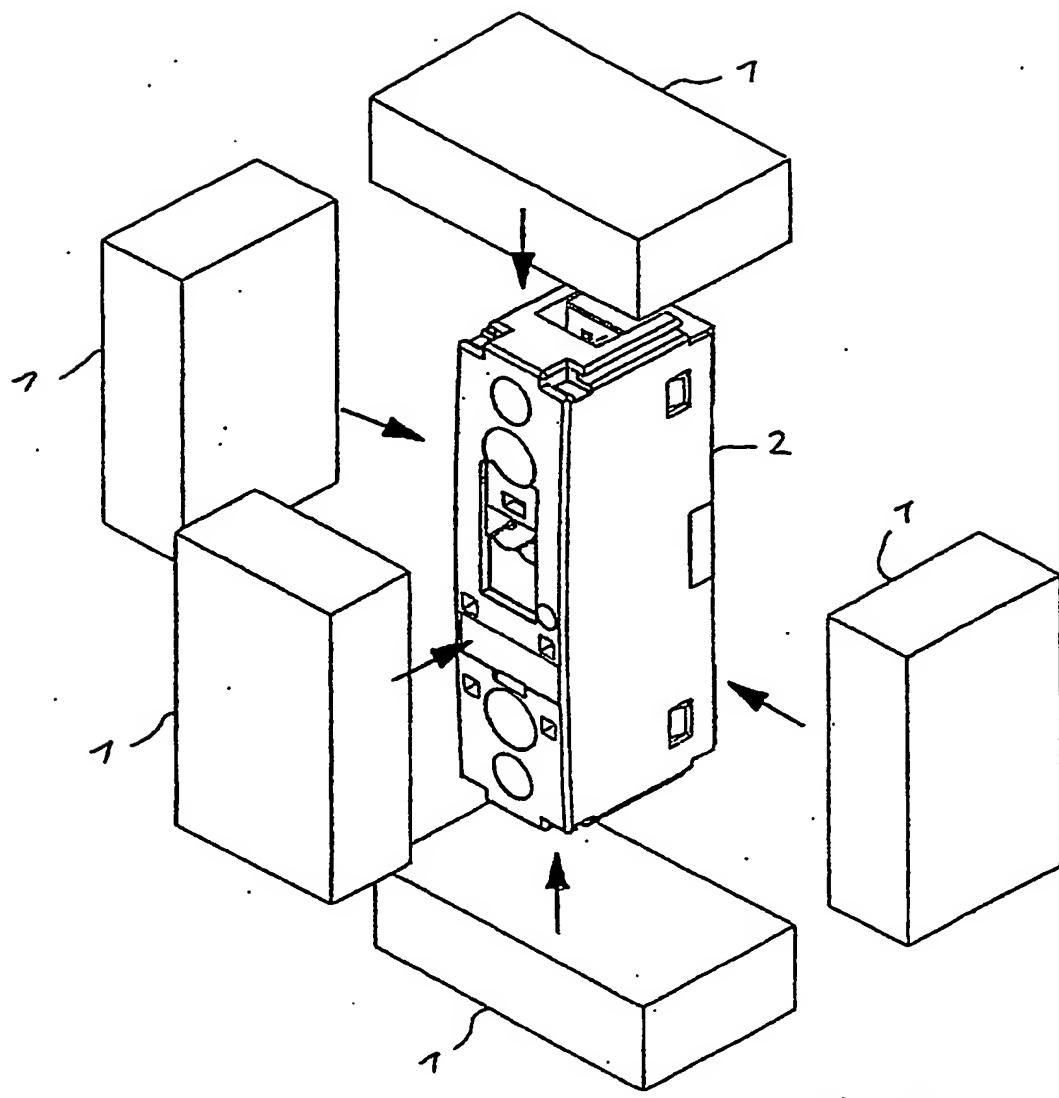


Fig. 70